

ALPHA

PAL153 Installation Guide

Jan, 2009

X001ZF0R-A

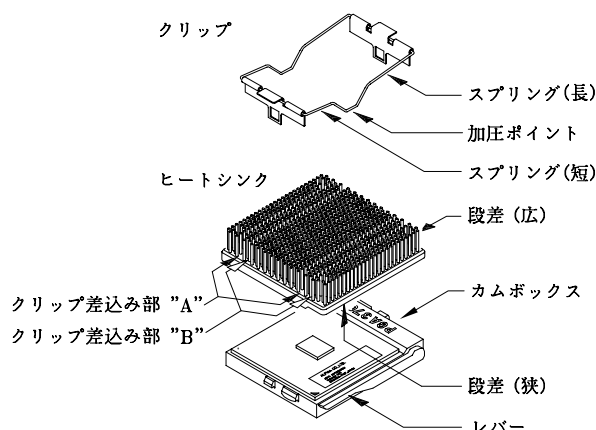
梱包の中に次の物が同梱されているか、ご確認ください。

部 品	数 量	モ デ ル	
		PAL153T	PAL153U-M63
ヒートシンク	1	○	○
クリップ	CL57L1	○	○
ネジ、ワッシャー	(ファン取付用)	○	○
ファン	(60mm角ファン)		○
サーマルグリス	YG6260-5		○
パッド		○	○

STEP 1 ヒートシンクユニット組立て前に他部品やソケットのレバー等との干渉が無いか確認してください。ヒートシンク裏面の狭い段差がソケットのレバー側、広い段差がソケットのカムボックス側になります。クリップはソケットに対し必ず右図に示す方向に組み込んで下さい。

クリップは非対称で、加圧ポイントが中心からずれています。加圧ポイントはCPUコアの上になければなりません。クリップのスプリングの長い方がベース裏面の広い段差側(カムボックス側)になる様に組付けます。

ヒートシンクにはクリップを差込む部分が2箇所あります。ヒートシンクの中心に対してクリップが各々片側に約3mmオフセットして取付ける位置にあります。一般的にはクリップ差込み部“A”を使用しますが、ソケットのレバー側に干渉するコンポーネントがある場合、“B”の方にクリップを組み付けて下さい。



STEP 2 ヒートシンクにクリップを差し込みます。次にファンを載せ、ネジをヒートシンクのベース面迄通して組付けて下さい。

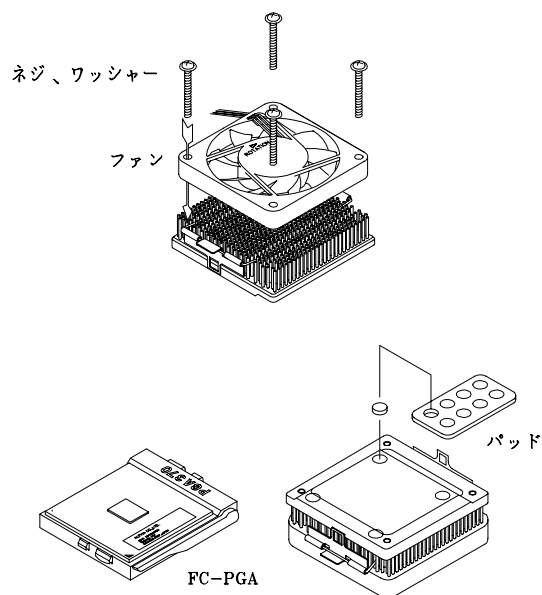
STEP 3 ベース面には防錆油が塗布されています。次項に示すとおり、FC-PGAに使用する場合はパッドを貼り付けますのできれいな布等で油分を取り除いて下さい。

STEP 4 •FC-PGAに使用する場合
ヒートシンク裏面4箇所の丸いマークの位置にパッドを貼付けて下さい。(右図参照) 残ったパッドはスペアとして保管して下さい。

•PPGA, Athlon, Duronに使用する場合
パッドを貼り付ける必要はありません。

STEP 5 ヒートシンクとCPUの接触面 おののにサーマルグリスを薄く均一に塗布して下さい。サーマルグリスの量が多いと性能低下につながりますので注意して下さい。ボードへのダメージを避ける為、過度に荷重をかけないでください。過度の荷重は設置ミスの原因にもなります。クリップはソケットタブの正しい位置に引っ掛けてください。

STEP 6 電源を入れる前に、ヒートシンクがCPUと傾くことなく設置されているか(ソケットのカムボックスやレバー及び他のコンポーネント等に接触せず、CPUだけに正しく接触していることを)目視で確認して下さい。



information subject to change without notice.